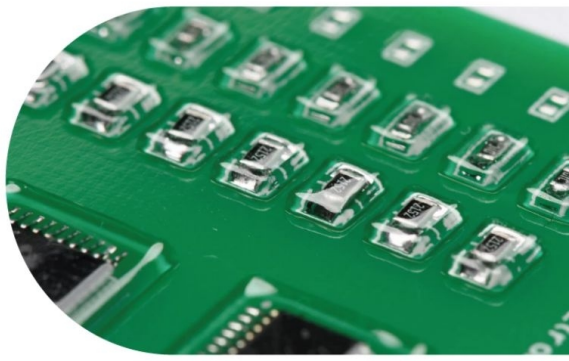
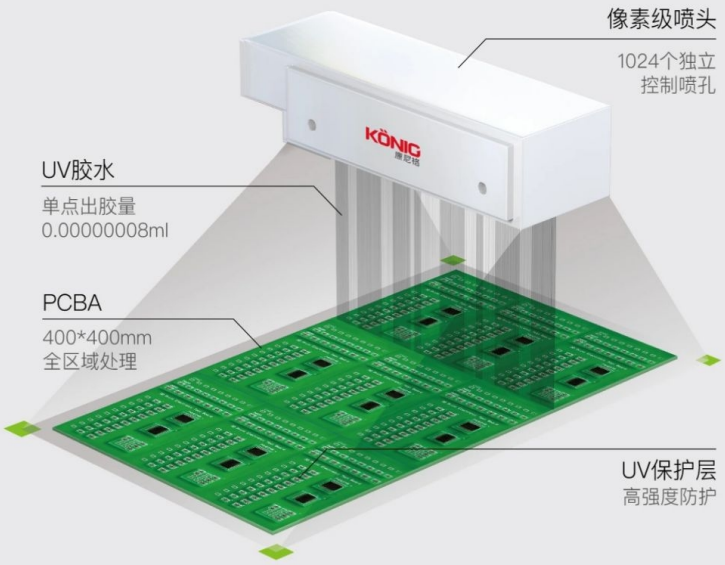
KP400

KÖNIG 康尼格

Digital Packaging
Technology For PCBA
电路板数字化封装设备

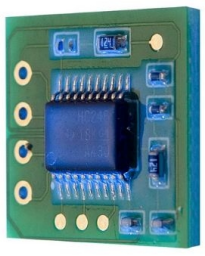


PCBA像素级封装
全区域处理技术
Pixel level whole area processing technology for PCBA

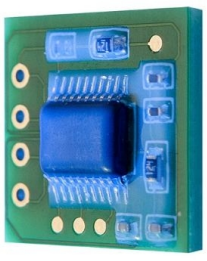


多样化的封装保护模式

点胶，涂覆。一台设备即可实现不同类型，不同等级的防护。



薄层喷涂
一般防护



厚层喷涂
高等级铠甲防护

围栏+填充
同款UV胶

单独围栏
填充任意胶水

生态亮点：通过喷射打印进行选择性保护，减少胶水的浪费；UV Led跟随固化，无溶剂挥发，绿色环保。

KP400

KONIG 康尼格

电路板数字化封装设备

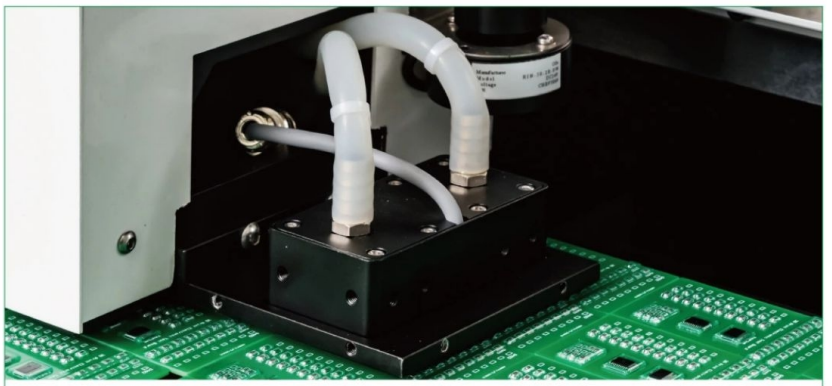
全区域处理逻辑丨阵列式喷头丨无需遮蔽工序

Whole region processing丨Array printing nozzle 丨No masking process

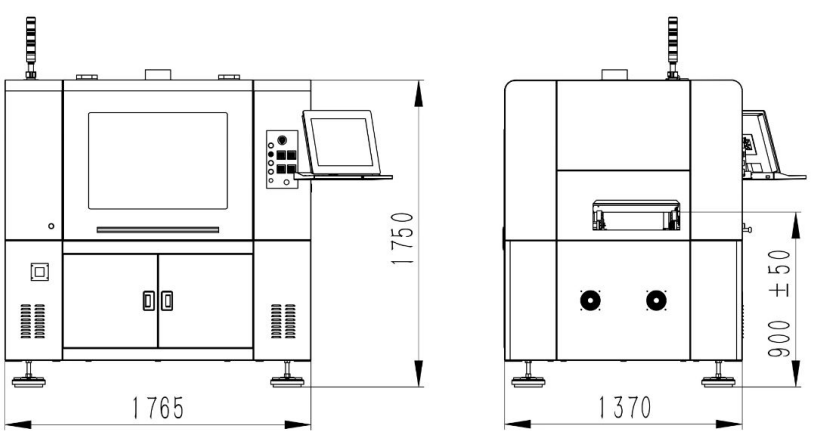
设备简介

KP400将3D打印技术应用于电子封装保护领域，是一款全新概念的产品封装保护设备。将UV胶水精准的喷射至需要防护的区域，通过多层堆叠形成各种3D形态，为PCBA、FPC等元器件提供高强度的保护。

工业级压电喷头、高可靠4轴运动平台



高精度CCD定位系统、双头水冷UV LED固化系统



封装厚度/速度	参数	备注
单层封装厚度	0.025 mm	
多层封装厚度	3 mm	多层堆叠总厚度
最快单层封装速度	18 s	400*400 mm
轴速		
运动轴数	3	
最快移动速度（XY/Z）	250/50 mm/s	
精度		
封装定位精度	±0.1 mm	
重复精度	±0.05 mm	
工作范围		
X、Y轴最大有效工作面积	400mm*400mm	
最大工作载荷	5 kg	
PCB特性		
元件最大高度	10 mm	
系统控制		
软件系统	KP400 Smart Software	自主知识产权IPR
Windows操作系统	Win10	
电源		
电源	220V / 50Hz / 4.5kW	
压缩空气	0.5Mpa以上	
环境温度范围	17-28°C	
相对空气湿度	45<70%RH	
设备尺寸		
尺寸（长宽高）	1765*1370*1750 mm	
重量	1500 kg	
主要部件		
喷头	工业压电喷头	
驱动电机（XY/ZR）	XY轴安川伺服电机，ZR轴日本信浓步进电机	
胶水固化系统	双头UV LED、水冷型	
*视觉定位系统	500W工业相机，高精度远心镜头	
墨路系统	独立双循环墨路	
传送轴	精密研磨丝杠C5	
轨道数据		
元件最大高度	输送面上30下100mm	
点胶行程	双头：X400mm Y500mm Z30mm	
输送高度	900+/-50mm	
输送速度	2-5m/min	
传送带类型	耐高温防静电皮带	
传送方向	L→R(R→L选配)	
PCB边缘空间	≥3mm	

附着力测试	0级	GB/T 9286 –1998
耐高温高湿	表面无明显变化，无起泡、无生锈、无裂纹、无剥落（85℃/85%RH，1000h）	IEC 60068
耐冷热冲击	表面无明显变化，无裂纹、无剥落（-40℃/30min~1min~80℃/30min，循环250h）	IEC 60068–2–14–1986
耐盐雾测试	无明显变化（中性盐雾300h）	GB/T 1771–2007
耐霉菌测试	0级	GB/T 1741–2007

*500W工业相机，高精度远心镜头 Basler, Germany.Moritex, Japan

苏州康尼格电子科技股份有限公司 Suzhou KONIG Electronic Technology Co., Ltd

江苏省·苏州市·常熟辛庄镇长盛路33号 No.33 Changsheng Road, Xinzhuang, Changshu, Suzhou

T +86-512-5247 9018 | F +86-512-5247 9098 | E info@konig.hk

公司官网